

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

聚辰半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-009

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研	<input type="checkbox"/> 分析师会议	<input type="checkbox"/> 媒体采访	
	<input type="checkbox"/> 业绩说明会	<input type="checkbox"/> 新闻发布会	<input type="checkbox"/> 路演活动	
	<input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 其他		
参与单位	广发证券	嘉实基金	恒越基金	泉果基金
	申万菱信基金	百嘉基金	道生投资	源乘基金
	汇安基金	天风证券	开源证券	鑫然投资
	国泰基金	乐信投资	国寿安保基金	金信基金
	兴业基金	圆信永丰基金	白犀基金	合道资产
	浙商基金	神农投资	志开投资	开源证券
	上海国际信托	海富通基金	新华基金	九泰基金
	潼骁投资	平安基金	太平基金	长江证券
	西部利得基金	盛宇投资	中银国际证券	Foundation Asset Management
	瑞华投资	天治基金	创金合信基金	鑫元基金
	申万宏源证券	华能贵诚信托	上银基金	Anatole Investment Management
	途灵资产	光大理财	长安基金	猎投资本
	路博迈基金	交银施罗德基金	太平资产	太平科技保险
	汇添富基金	正圆基金	富敦投资	安联基金
	德邦基金	金鹰基金	天安财产保险	中银基金
	长信基金	华宝基金	前海开源基金	世纪前沿基金
	兴证全球基金	中银基金	中国银河证券	泽泉投资
	西部利得基金	诺德基金	创富兆业金融	远信基金
	平安养老保险	财信基金	名禹资产	复胜资产

	申万宏源证券	POINT72	国联基金	摩根士丹利基金
	昊青资产	国泰海通证券	榕树投资	中海基金
	中国人寿养老保险	中信银行	同方证券	青榕资产
	Franklin Templeton	宝盈基金	东盈投资	运舟基金
	华泰证券	敦和资产	中庚基金	淳厚基金
	中信建投证券	华安基金	中信保诚基金	东吴人寿保险
	中泰证券	东方证券资管	南土资产	元葵资产
	天壹紫腾资产	杭银理财	中信证券	Grandeur Peak
	中金公司	摩根基金	鹏华基金	大华继显证券
	中兵财富资产	重阳投资	易方达基金	汐泰投资
	西南证券	兴业银行	东北证券	工银瑞信基金
	诚通证券	招银理财	华安证券	今赫资产
	Trivest Advisors	安联基金	北信瑞丰基金	中邮证券
	中才中环投资	泓澄投资	金科投资	T Rowe Price
	国华保险	信达澳亚基金	长城证券	瓴仁投资
	浙商证券	华泰资产	人保资产	华夏久盈
	盘京投资	财通资管	广发基金	永赢基金
	晨燕资产	精砚资本	平安资产	华商基金
	磐泽资产	新华资产	鹏扬基金	
活动时间	2025年10月29日			
活动地点	网络会议			
接待人员	职 务		姓 名	
	董事、董事会秘书		翁华强	
	全球市场副总裁		邵 丹	
	投资者关系总监、董事会办公室副主任		孙 远	

<p>活动主要内容</p>	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司董事、董事会秘书翁华强先生向与会投资者介绍了公司 2025 年前三季度的经营情况。</p> <p>二、投资者交流环节</p> <p>1、前三季度营收同比大幅增长的原因</p> <p>今年前三季度公司实现营业收入 9.33 亿元，较上年同期增长 21.29%，其中第三季度营收为 3.58 亿元，同比分别增长 40.70%，均创下历史同期最好成绩。这主要系受益于公司近年来持续完善在高附加值市场的产品布局，报告期内 DDR5 SPD 芯片、汽车级 EEPROM 芯片和高性能工业级 EEPROM 芯片等产品的销售收入较上年同期实现快速增长所致。</p> <p>2、计提资产减值准备对三季度公司利润的影响</p> <p>今年前三季度公司实现归母净利润为 3.20 亿元，同比增长 51.33%，其中第三季度净利润为 1.15 亿元，同比增长 67.69%，均创下历史同期最好成绩。基于谨慎性原则，第三季度公司对部分产品计提了约 2000 万元的资产减值准备，扣除该影响后的利润总额达到 1.4 亿元。</p> <p>3、第三季度毛利率微降的原因</p> <p>三季度公司综合毛利率环比二季度有细微降幅，原因主要是消费电子业务回暖，而消费电子领域产品毛利率相对较低，拉低了综合毛利率。从长期看，公司高附加值产品营收占比会不断提升，综合毛利率整体呈上升趋势。</p> <p>4、SPD 芯片可否用在 SOCAMM2</p> <p>公司 SPD 芯片主要应用于服务器领域的 SOCAMM2、RDIMM、LRDIMM、MRDIMM 等内存模组以及计算机领域的 UDIMM、SODIMM、LPCAMM2 等内存模组，为 DDR5 内存模组不可或缺的组件，也是内存管理系统的关键组成部分。随着全球数据总量的爆发式增长，服</p>
---------------	---

务器和计算机作为算力承载的基础设施，将带动 DDR5 内存模组需求量的提升。

5、汽车级 NOR Flash 的进展

公司汽车级 NOR Flash 芯片已成功导入多家全球领先的汽车电子 Tier1 供应商，在多款主流品牌汽车的视觉感知和智能座舱系统中应用，下游客户与汽车级 EEPROM 芯片客户重合度高，销售效率较高，目前该业务出货量不断增加，进一步完善了在汽车电子领域的产品布局。

6、光学防抖式（OIS）驱动芯片的进展

公司是全球领先的开环式音圈马达驱动芯片供应商，并基于在智能手机摄像头模组领域拥有丰富的客户资源和良好的品牌背书，持续向闭环式和光学防抖式驱动芯片等更高附加值的领域拓展。前三季度公司光学防抖式（OIS）音圈马达驱动芯片已搭载在主流智能手机品牌的多款中高端机型实现商用，出货量快速增长，进一步优化了音圈马达驱动芯片业务的产品结构。

7、AI 眼镜领域产品

公司 WLCSP EEPROM 芯片已在 AI 眼镜摄像头模组领域卡位，在市场主要品牌的 AI 眼镜产品中取得大规模应用，但目前 AI 眼镜年度出货量较少，若 AI 眼镜未来能够实现在功能、续航、重量等方面的平衡，有望成为公司消费电子领域新的增长点。

8、研发投入情况

公司持续提升研发水平，不断完善技术储备和产品布局，前三季度的研发投入达到 1.46 亿元，同比增长 12.62%，为历史同期最高水平，为进一步丰富公司的业务结构、提升公司的盈利能力和综合竞争力奠定了坚实基础。

附件清单

无